Agustín Colombo Sierra

| | | Agustin Colombo Sierra |
|---------------|---|---------------------------------------|
| 7309.00.90 | 60% de valor agregado regional | Director |
| 7310.10.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7310.10.90 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7310.21.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7310.21.90 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7310.29.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regionar |
| 7310.29.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7310.29.90 | Salto de partida arancelario más 60% de valor a | agregado regional |
| 7311.00.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7321.11.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7321.81.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7326.90.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 7326.90.90 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 8207.19.00 (7 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 8207.30.00 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8301.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8401.10.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor a | agregado regional |
| 8401.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8401.40.00 | 60% de valor agregado regional | MEQ |
| 8402.11.00 | 60% de valor agregado regional | SOAMERICA, |
| 8402.12.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8402.19.00 | 60% de valor agregado regional | SECRETARIA Z |
| 8402.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8402.90.00 | 60% de valor agregado regional | 15 TREKAL TO |
| 8403.10.90 | 60% de valor agregado regional | 3 8 |
| 8403.90.00 | 60% de valor agregado regional | OSK NOW |
| 8404.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8404.10.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8404.20.00 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional | |
| 8404.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8404.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8405.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8405.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8406.10.00 | 60% de valor agregado regional | <u>.</u> |
| 8406.81.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8406.82.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8406.90.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8406.90.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 3406.90.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 3406.90.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 3407.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 3407.21.10 | 60% de valor agregado regional | · |
| 3407.21.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 407.29.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 407.29.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 407.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 408.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 408.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 408.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 408.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 409.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 410.11.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 410.12.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 410.13.00 | 60% de valor agregado regional | |
| | | |

9

5/4

Sd

Agustín Colombo Sierra Director

| | | Director |
|------------|--|------------------|
| 8410.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8411.11.00 | 60% de valor agregado regional | OMERICANY OF |
| 8411.12.00 | 60% de valor agregado regional | MERICANA |
| 8411.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8411.22.00 | 60% de valor agregado regional | ARIA CIVI |
| 8411.81.00 | 60% de valor agregado regional | SECRE BAL |
| 8411.82.00 | 60% de valor agregado regional | 1/2 GET 50// |
| 8411.91.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8411.99.00 | 60% de valor agregado regional | 7305V · 140 |
| 8412.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.21.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.31.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.31.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.39.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.80.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.90.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.90.80 | 60% de valor agregado regional | |
| 8412.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.11.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.19.00 | 60% de valor agregado regional | |
| | | · |
| 8413.40.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.50.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.50.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.60.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.60.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.60.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.70.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.70.80 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.70.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.81.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.82.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.91.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.91.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8413.92.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.30.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.30.99 | 60% de valor agregado regional | <u></u> |
| 8414.40.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.40.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.40.90 | 60% de valor agregado regional | _ ` |
| 8414.51.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor ag | gregado regional |
| 8414.59.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.59.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.80.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.80.12 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.80.13 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.80.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.80.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8414.80.22 | 60% de valor agregado regional | • |
| 8414.80.29 | 60% de valor agregado regional | |
| | | |
| 8414.80.31 | 60% de valor agregado regional | |

Agustín Colombo Sierra

| 8414.80.33 | 60% de valor agregado regional |
|--------------------------|--|
| 8414.80.38 | 60% de valor agregado regional |
| 8414.80.39 | 60% de valor agregado regional |
| 8414.80.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8414.90.10 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8414.90.31 | 60% de valor agregado regional |
| 8414.90.32 | 60% de valor agregado regional |
| 8414.90.33 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8414.90.34 | 60% de valor agregado regional |
| 8414.90.39 | 60% de valor agregado regional |
| 8415.10.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8415.20.90 | 100 % de valor agregado regionar |
| 8415.81.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8415.82.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8415.83.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8415.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8416.10.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8416.20.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8416.20.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8416.30.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8416.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.10.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.10.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.10.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.20.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.80.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.80.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.80.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8417.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8418.50.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8418.50.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8418.69.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8418.69.20 8418.69.91 | 60% de valor agregado regional |
| 8418.69.99 | 60% de valor agregado regional |
| 8418.99.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.20.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.31.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.32.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.39.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.40.10 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8419.40.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.40.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.50.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8419.50.21 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.50.22 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.50.29 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.50.90 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.60.00 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.81.10 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.81.90 | 60% de valor agregado regional |
| 3419.89.11 | 60% de valor agregado regional |
| 419.89.19 | 60% de valor agregado regional |
| 419.89.20 | 60% de valor agregado regional |
| <u> </u> | |

Agustín Colombo Sierra

| | | Director |
|--------------------------|---|--|
| 8419.89.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8419.89.40 | 60% de valor agregado regional | GAN |
| 8419.89.91 | 60% de valor agregado regional | AERICANA O. |
| 8419.89.99 | 60% de valor agregado regional | 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 |
| 8419.90.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8419.90.31 | 60% de valor agregado regional | T ECREERAL Q |
| 8419.90.39 | 60% de valor agregado regional | SECRETAL OF SECRET |
| 8419.90.40 | 60% de valor agregado regional | To GE |
| 8419.90.90 | 60% de valor agregado regional | MOOSA. |
| 8420.10.10 | 60% de valor agregado regional | 050 |
| 8420.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8420.91.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8420.99.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.11.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.11.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.12.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.19.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.19.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.21.00 | 60% de valor agregado regional | - |
| 8421.22.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.29.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.29.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.29.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.29.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.29.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.39.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.39.30 | 60% de valor agregado regional | |
| | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.39.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.91.91 8421.91.99 | 60% de valor agregado regional | |
| | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.99.10 | | |
| 8421.99.91 | 60% de valor agregado regional | |
| 8421.99.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.19.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.30.21 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional | |
| 8422.30.22 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.30.23 | | |
| 8422.30.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.30.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.40.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.40.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.40.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.40.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8422.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.30.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.30.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.81.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.81.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.82.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8423.89.00 | 60% de valor agregado regional | |

& St

The

Agustín Colombo Sierra

| | | Director |
|------------|----------------------------------|--|
| 8423.90.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8424.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8424.30.10 | 60% de valor agregado regional | No. of the last of |
| 8424.30.20 | 60% de valor agregado regional | AMERICA A |
| 8424.30.30 | 60% de valor agregado regional | T. A. |
| 8424.30.90 | 60% de valor agregado regional | 4 m |
| 8424.81.19 | 60% de valor agregado regional | SECRETARIA Z |
| 8424.81.21 | 60% de valor agregado regional | O GENERAL |
| 8424.81.29 | 60% de valor agregado regional | 10 8/ |
| 8424.81.90 | 60% de valor agregado regional | 100 |
| 8424.89.90 | 60% de valor agregado regional | Ser. Moss |
| 8424.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.11.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.19.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.31.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.31.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.39.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.39.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.41.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8425.49.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.11.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.12.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.19.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.30.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.41.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.41.90 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8426.49.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.49.90 | 60% de valor agregado regional | - |
| 8426.91.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8426.99.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8427.10.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8427.10.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8427.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8427.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8427.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8427.90.00 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8428.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.31.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.32.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.33.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.39.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.39.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8428.39.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.39.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.40.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.60.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.90.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.90.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 3428.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 3429.11.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 725.11.10 | 100 % de valui agregado regional | |

les H

5 <u>h</u>

N

Agustín Colombo Sierra Director

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Director |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 8429.11.90 | 60% de valor agregado regional | DE CRETAN ST | |
| 8429.19.10 | 60% de valor agregado regional | -RICANA | |
| 8429.19.90 | 60% de valor agregado regional | DATE OF THE | |
| 8429.20.10 | 60% de valor agregado regional | 3 SECRETAND STATES | |
| 8429.20.90 | 60% de valor agregado regional | E SETAN TO | |
| 8429.30.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.40.00 | 60% de valor agregado regional | Z GL O | |
| 8429.51.11 | 60% de valor agregado regional | 10/2 | |
| 8429.51.19 | 60% de valor agregado regional | DOSA - NO | ······································ |
| 8429.51.21 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.51.29 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.51.91 | 60% de valor agregado regional | | <u> </u> |
| 8429.51.92 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.51.99 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.52.11 | 60% de valor agregado regional | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8429.52.12 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.52.19 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429,52.20 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 8429.52.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8429.59.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.10.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.20.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.31.10 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.31.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.39.10 | 60% de valor agregado regional | | · |
| 8430.39.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.41.10 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.41.20 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.41.30 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.41.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.49.10 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.49.20 | 60% de valor agregado regional | | ··· |
| 8430.49.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.50.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.61.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.69.11 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.69.19 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8430.69.90 | 60% de valor agregado regional | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8431.10.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.20.11 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.20.19 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.20.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.31.10 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.31.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.39.00 | 60% de valor agregado regional | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8431.41.00 | | | |
| 8431.42.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.43.10 | 60% de valor agregado regional | | |
| | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.43.90 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.49.10 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.49.21 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8431.49.29 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8432.10.00 | 60% de valor agregado regional | | |
| 8432.21.00 | 60% de valor agregado regional | | |

les

Bf-

DA

Agustín Colombo Sierra Director

| | | Director |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| 8432.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8432.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8432.30.90 | 60% de valor agregado regional | AMERICAL SECTION OF THE SECTION OF T |
| 8432.40.00 | 60% de valor agregado regional | JOAN LINCAN |
| 8432.80.00 | 60% de valor agregado regional | 7 |
| 8432.90.00 | 60% de valor agregado regional | SECRET |
| 8433.20.10 | 60% de valor agregado regional | SECRETARIA Z |
| 8433.20.90 | 60% de valor agregado regional | NE THERAL |
| 8433.30.00 | 60% de valor agregado regional | 13 8/ |
| 8433.40.00 | 60% de valor agregado regional | OSP MOIS |
| 8433.51.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.52.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.53.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.59.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.59.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.59.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.60.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.60.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.60.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.60.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8433.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8434.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8434.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8434.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8434.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8435.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8435.90.00 | 60% de valor agregado regional | <u> </u> |
| 8436.10.00 | | |
| 8436.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8436.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8436.80.00 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8436.91.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8436.99.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8437.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8437.80.10 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8437.80.10 8437.80.90 | 60% de valor agregado regional | |
| | 60% de valor agregado regional | |
| 8437.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.20.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.20.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.30.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.40.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.50.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.60.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.80.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.80.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.80.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8438.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8439.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8439.10.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8439.10.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 3439.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 3439.20.00 | 60% de valor agregado regional | ···· |

Agustín Colombo Sierra Director

| r | Director |
|---------------|--|
| 8439.30.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8439.30.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8439.30.30 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8439.30.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8439.91.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8439.99.10 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8439.99.90 | 160% de valor agregado regional |
| 8440.10.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8440.10.20 | 100 % de valor agregado regional |
| 8440.10.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8440.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.10.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.10.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.20.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.30.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.30.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.40.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.80.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8441.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.30.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.30.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.30.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.40.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.40.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.40.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8442.50.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.11.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.11.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.12.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.13.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.13.21 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.13.29 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.13.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.14.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.15.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.16.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.17.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.17.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.19.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.19.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.31.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.32.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| , | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | |

la sp.

Shen

Agustín Colombo Sierra Director

| | Director |
|--|---|
| 9442 22 42 | alimentación. |
| SECRETARIA Z Z GENERAL GO OSV. NO. | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.13 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 3443.32.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |

les

货

49

Slen



Agustín Colombo Sierra

| - NOCE - NOCE | Director |
|---------------|---|
| SOZA. | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8443.32.22 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.23 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.29 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.35 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |

les

68

SU

SECRETARIA Z SECRETARIA Z Z GENERAL SI

SECRETARÍA DEL MERCOSUR RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10 FE DE ERRATAS – ORIGINAL-15/IV/2010

Agustín Colombo Sierra

| GENERAL G | Director |
|---|---|
| Son · Noce | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| Sty. NO | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| 2442.00.00 | alimentación. |
| 8443.32.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| 1 | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| İ | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| Í | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
|] | del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| 1 | Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| · · | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.51 | |
| , | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| 1 | en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | ly 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | Impresoras de linea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siemore que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B" No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| 2442.22.22 | alimentación. |
| 8443.32.59 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso, B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| | 60% de valor agregado regional |
| 443.39.21 | 60% de valor agregado regional |
| 443.39.28 | 60% de valor agregado regional |
| 443.39.29 | 60% de valor agregado regional |
| | 60% de valor agregado regional |
| | 60% de valor agregado regional |
| | 60% de valor agregado regional |
| | agregate regional |

lez

g-

Sle



TA SECRETARIA TO SECRETARIA TO SECRETARIA DO SECRETARIA DO SECRETARIA DO SECRETARIA DE
SECRETARÍA DEL MERCOSUR RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10 FE DE ERRATAS – ORIGINAL-15/IV/2010

Agustín Colombo Sierra

| Z- ASOCK | Director |
|--------------------------|---|
| 8443.91.91 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.91.92 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.91.99 | 60% de valor agregado regional |
| 8443.99.11 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O |
| | ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito |
| | impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida |
| | 8473.30. |
| 8443.99.13 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;B – Montaje y |
| ' | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8443.99.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:A - Montaje |
| 0443.33.13 | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;B – Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8443.99.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| • | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los item 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8443.99.24 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| : | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 0442.00.24 | |
| 8443.99.31 8443.99.39 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8444.00.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8444.00.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8444.00.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8445.11.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8445.11.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8445.11.90 | 60% de valor agregado regional |
| UTTU. 1 1.30 | 100 /s do valor agregado regional |

les of

She

Agustín Colombo Sierra

| | | Director |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 8445.12.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.13.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.19.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.19.21 | 60% de valor agregado regional | 11.70 |
| 8445.19.22 | 60% de valor agregado regional | ON MERICANA |
| 8445.19.23 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.19.24 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.19.25 | 60% de valor agregado regional | SECRETARIA Z |
| 8445.19.26 | 60% de valor agregado regional | GENERAL DI |
| 8445.19.27 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.19.29 | 60% de valor agregado regional | Sr 100 |
| 8445.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.12 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.18 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.31 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.39 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.40 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.40.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.90.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.90.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.90.40 | 60% de valor agregado regional | |
| 8445.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.30.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.30.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.30.40 | 60% de valor agregado regional | |
| 8446.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.11.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.12.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.20.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.20.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.20.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8447.90.20 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8447.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.11.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.11.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.11.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.19.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.20.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.20.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 3448.20.90 | 60% de valor agregado regional | |

by

SJ.

s Sle

Agustín Colombo Sierra

| | | Director |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 8448.31.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.32.11 | 60% de valor agregado regional | SERICANA |
| 8448.32.19 | 60% de valor agregado regional | Ser. O. |
| 8448.32.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.32.30 | 60% de valor agregado regional | TAK! |
| 8448.32.40 | 60% de valor agregado regional | J SECRETAL OF |
| 8448.32.50 | 60% de valor agregado regional | TO GENT |
| 8448.32.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.33.10 | 60% de valor agregado regional | SOSA • |
| 8448.33.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.12 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.17 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.22 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.23 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.91 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.92 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.39.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.42.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.49.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.49.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.49.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.51.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.59.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.59.22 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.59.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.59.30 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.59.40 | 60% de valor agregado regional | |
| 8448.59.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8449.00.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8449.00.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8449.00.80 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8449.00.91 | 60% de valor agregado regional | |
| 8449.00.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8450.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8450.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8450.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.29.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.29.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.30.99 | 60% de valor agregado regional | <u> </u> |
| 8451.40.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.40.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.40.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.40.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.50.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.50.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.50.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.80.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8451.90.90 | 60% de valor agregado regional | |

Agustín Colombo Sierra

| | | Agustin Colombo Sierra Director |
|------------|---|--|
| 8452.21.10 | 60% de valor agregado regional | Director |
| 8452.21.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.21.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.29.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.29.21 | 60% de valor agregado regional | OAMERICAL |
| 8452.29.22 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.29.23 | 60% de valor agregado regional | 3 |
| 8452.29.24 | 60% de valor agregado regional | SECRETARIA Z |
| 8452.29.25 | 60% de valor agregado regional | GENERAL TO |
| 8452.29.29 | 60% de valor agregado regional | 8// |
| 8452.29.90 | 60% de valor agregado regional | SOLV MODE |
| 8452.30.00 | 60% de valor agregado regional | 35. NO. |
| 8452.90.91 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.90.92 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.90.93 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.90.94 | 60% de valor agregado regional | |
| 8452.90.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8453.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8453.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8453.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8453.80.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8453.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.30.20 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional | |
| 8454.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.90.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8454.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.21.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.21.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.22.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.22.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.30.20 | 60% de valor agregado regional | |
| 8455.30.90 | 60% de valor agregado regional | ······································ |
| 8455.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8456.10.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8456.10.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8456.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8456.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8456.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 3456.30.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 3456.30.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 3456.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 3456.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 3457.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 3457.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 457.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 3457.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 457.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 458.11.10 | 60% de valor agregado regional | |
| | 60% de valor agregado regional | |

Agustín Colombo Sierra Director

| | | Director |
|------------|---|---------------------------------------|
| 8458.11.91 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8458.11.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8458.19.10 | 60% de valor agregado regional | DENERICANY ORNERICANY |
| 8458.19.90 | 60% de valor agregado regional | MERICANA |
| 8458.91.00 | 60% de valor agregado regional | (9) |
| 8458.99.00 | 60% de valor agregado regional | SECRETARIA Z |
| 8459.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.21.10 | 60% de valor agregado regional | Z GENE 2011 |
| 8459.21.91 | 60% de valor agregado regional | 1197 |
| 8459.21.99 | 60% de valor agregado regional | 30ch - M |
| 8459.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.31.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.39.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.40.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.51.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.59.00 | 60% de valor agregado regional | - |
| 8459.61.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8459.69.00 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8459.70.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.11.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.19.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.31.00 | | |
| 8460.39.00 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional | |
| 8460.40.11 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8460.40.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.40.91 | 60% de valor agregado regional | |
| | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.40.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.90.11 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8460.90.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8460.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.40.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.40.91 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.40.99 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8461.50.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461.50.20 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8461.50.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8461,90.10 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8461.90.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.10.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.10.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.29.00 | 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8462.31.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.39.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.39.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462,41.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8462.49.00 | 60% de valor agregado regional | |

Agustín Colombo Sierra

| | Director |
|------------|---|
| 8462.91.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8462.91.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8462.91.91 | 60% de valor agregado regional |
| 8462.91.99 | 60% de valor agregado regional |
| 8462.99.10 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8462.99.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8462.99.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.10.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.10.90 | 60% de valor agregado regional Q GENERAL |
| 8463.20.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.20.91 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.20.99 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.30.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.90.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8463.90.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.10.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.20.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.20.21 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.20.29 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.20.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.90.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.90.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8464.90.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.10.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.91.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.91.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.91.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.92.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.92.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.92.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.93.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.93.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.94.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.95.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.95.12 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.95.91 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.95.92 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.96.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8465.99.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.10.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.20.10 | 60% de vaior agregado regional |
| 8466.20.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.30.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.91.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.92.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.93.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.93.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.93.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.93.30 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.93.40 | 60% de valor agregado regional |
| | 60% de valor agregado regional |
| 8466.93.60 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.94.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.94.20 | 60% de valor agregado regional |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

les of

7

Agustín Colombo Sierra Director

| | Director |
|------------|---|
| 8466.94.30 | 60% de valor agregado regional |
| 8466.94.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8467.11.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8467.11.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8467.19.00 | 160% de valor agregado regional // U |
| 8467.29.93 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 50% de valor agregado regional |
| 8467.81.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8467.89.00 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 7 SECRETAL OI 60% de valor agregado regional |
| 8467.91.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8467.92.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8467.99.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8468.20.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8468.80.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8468.80.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8468.90.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8468.90.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8469.00.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8470.50.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| 0.50.11 | componentes en las placas de circuito impreso; C. Integración de las placas de |
| 1 | circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto |
| | final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los |
| | siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para |
| | impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem |
| | 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) |
| | Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de |
| | línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de |
| | subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| 1 | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8470.50.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nível básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| <u> </u> | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| ļ | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| ! | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8470.50.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8470.90.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8470.90.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8471.30.12 | MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES REQUISITO: Cumplir con el siguiente |
| | proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas |
| | de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, |
| | las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las |
| | interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las |
| | unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, |
| | placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación |
| | |

la

g/-

She,

| The state of the s | FE DE ERRATAS - ORIGINAL-15/IV/2010 |
|--|---|
| MERICAN | |
| ZZ 30 1 | Agustín Colombo Sierra |
| \$ | Director |
| SECRETARIA Z | de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos |
| GENERAL TO | sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente |
| | desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de |
| 150 00 | circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto |
| DON . NOON | final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los |
| Control of the Contro | siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y |
| | 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del |
| | régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades |
| | de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación |
| 8471.30.19 | MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES REQUISITO: Cumplir con el siguiente |
| | proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas |
| 1 | de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, |
| | las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las |
| | interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las |
| | unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, |
| l | placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación |
| | de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos |
| | sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente |
| | desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de |
| | circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto |
| | final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores Están exentos del montaje los |
| · | siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y |
| | 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del |
| | régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades |
| | de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación |
| 8471.30.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso;B. Montaje de las partes eléctricas y |
| | mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| · · | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| l | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8471.41.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| 047 1.41.50 | componentes en las placas de circuito impreso;B. Montaje de las partes eléctricas y |
| | mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| ľ | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| ì | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| 1 | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| 1 | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| 1 | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| 1 | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8471.50.10 | UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. |
| | REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura |
| | de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las |
| | |

la

of

59

The



Agustín Colombo Sierra Director

funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "discless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;

8471.50.20

UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones: B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.

8471.50.30

UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siquientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria: c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaie del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de

les sp.

Slen



Agustín Colombo Sierra Director

subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.

8471.50.40

UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE.

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A" incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.

8471.50.90

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

8471.60.52

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No

la of

Slen



| SE GENE | Agustín Colombo Sierra Director |
|------------|---|
| PROCE! | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.60.53 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.60.59 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.60.61 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.60.62 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |



| SECRETARIA TO | Agustín Colombo Sierra Director |
|--|---|
| SECRETARIA O GENERAL TO OSV. NOT | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.60.80 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.60.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.70.12 | DISCOS DUROS Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación. |
| 8471.70.19 | DISCOS DUROS Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con |

la of

The



| SECRERAL 2 | Agustín Colombo Sierra Director |
|------------|---|
| St. PROCHE | capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación. |
| 8471.70.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.70.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.80.00 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.90.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso: B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |

| AERICA | FE DE ERRATAS – ORIGINAL-15/IV/2010 |
|---|--|
| MONIMERICAN YOU | Aquatía Calamba Siarra |
| | Agustín Colombo Sierra Director |
| SECRETARIA ZI NO GENERAL SI OSV. NOTO | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.90.12 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.90.13 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | Alimentación. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8471.90.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |

les

g

65

Sle



| GENERAL CO | Agustín Colombo Sierra Director |
|--------------|---|
| OM PASOCH OF | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8472.10.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8472.30.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8472.90.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8472.90.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8472.90.29 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |

SECRETARIA Z GENERAL

SECRETARÍA DEL MERCOSUR RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10 FE DE ERRATAS – ORIGINAL-15/IV/2010

Agustín Colombo Sierra
Director

| | Director |
|--------------------------|---|
| OSA · MO | alimentación. |
| 8472.90.30 | 60% de valor agregado regional |
| 8472.90.59 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8472.90.91 | 60% de valor agregado regional |
| 8472.90.99 | 60% de valor agregado regional |
| 8473.10.10 8473.29.10 | 60% de valor agregado regional CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos |
| 8473.29.90 | los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| 2472 20 44 | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 473.30.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |

les

be.

Shi



Agustín Colombo Sierra Director

| <u> </u> | Director |
|------------|---|
| 4. A50CL | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.31 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.41 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. |
| 8473.30.42 | PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. |
| 8473.30.49 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. |
| 8473.30.99 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. |

les of

She

SECRETARIA Z O GENERAL S

SECRETARÍA DEL MERCOSUR RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10 FE DE ERRATAS – ORIGINAL-15/IV/2010

Agustín Colombo Sierra Director

| Están exentos del montaje los siguientes modulos o subconjuntos. 1) Mecanismos del fem 8473 30 22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) | O GENERAL | <u>Director</u> |
|--|-------------|--|
| y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los Item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitrá utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las parase eléctricas y mecánicas, totalimente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. de las partes electricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los Item "A" y "B" rateriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del Item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los Item 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8471.49.21 y 8471.60.11, Se admitriá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los Item "A" y "B" | | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| impresoras de linea de los Item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitra la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los Item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecânicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes, y C. Integración de las placas de circuito impreso; de las partes eléctricas y mecânicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes, y C. Integración de las placas de circuito impreso; de las partes eléctricas y mecânicas en la formación del producto final de acuerdo con los Item "A" y "B" anteriores. Están exentos del imen \$470.90 pl para apartos de "facsimil" de los Item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los Item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos immos atienda lo establecido en los Item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de las partes eléctricas y mecânicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de | OSA · NO | Mecanismos del ítem 8517 90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 |
| de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los tiem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso. B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso. El Montaje de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.02.2 para impresoras de las subpartidas 8471.49.2 y 8471.60.2, 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimit" 8471.60.2, 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimit" 8471.60.11. Se admitirá la utilitización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas en la formación de | | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 84/3.30.23 y 84/3.50.31 para |
| producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRONICOS. Montaje y solidadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRONICOS. Montaje y solidadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del item 8471.90.91 para aparatos de "icacsimil" de los mestar. 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8471.90.91 para aparatos de "icacsimil" de los mesta. 1) y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitir a utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo | 1 | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitira la utilización |
| desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRONICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRONICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las tentrales de las subpartidas 8471.49, 34, 9471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10; y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subtem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admittira la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con | | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.40.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS Montaje y solidadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y solidadura de las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; Y. C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8473.30.23 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos; y 3 Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, opticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes | İ | producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y B . No |
| alimentación. GIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuiti impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida P473.30. 8473.50.10 GIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida P473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida P473.30. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circutio impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circutio impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.34 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circutio impreso; de las partes eléctricas y mecánicas, notalmente de las palacas de circutio impreso | | desnaturaliza el cumplimiento del regimen de origen definido, la inclusion en un |
| ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRÓNICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A Montaje y soldadura de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subtitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21; 9471.60.11; se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" noteriores. Están exentos del imentados en los Es | | |
| ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. RA73.50.10 RA73.50.10 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del mentaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10; y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los sublitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo | | alimentación. |
| los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. GIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los Item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 9471.40.2; 2) Mecanismos del item 8473.70.90 pl para aparatos de "facsímil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subtem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.2; 2) desandurales al cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" noteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49 | 8473.40.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O |
| ELECTRÓNICOS. MONTADOS CON COMPONENTES ELECTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y solidadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto finat de acuerdo con los Item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; de las partes electricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los Item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de | | ELECTRONICOS. Montaje y solidadura en las placas de circulto impreso de todos |
| ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no parfan de la subpartida 8473.30. 8473.50.32 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecânicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecânicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8473.30.23 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8473.30.23 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "acsimil" de los item 8517.2.1.10 y 8517.2.12; y 3) Banco de martilios de los subtem 8473.30.32 y 8473.50.31 para impresoras de licen de los item 8471.49.2 y 8471. | | los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 0473.30. |
| los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentenes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los Item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.32 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; 9 de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los Item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montado | 8473.50.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COM CINTED ELECTRICOS O |
| Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los sublitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definicla, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del imontaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8471.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por tercercos, siempre que la pro | | Les componentes, signates que estos no partan de la subpartida 8473.30 |
| componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los sublitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y solidadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8817.90.19 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza | 6.670.50.00 | Cumpling componentes, siempre que estos no partan de la daspartida o maior. |
| y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definic, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subbtem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definiclo, la inclusión en un mismo cuerpo o ga | 8473.50.32 | componentes en las placas de circuito impreso. B. Montaie de las partes eléctricas |
| integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "faccimil" de los item 8517.21.20, y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item 8473." "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | <u> </u> | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| en la formación del producto final de acuerdo con los flem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los item 8517.21.00 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los fiem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pa | | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semic | | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los Item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los item "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subtem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de linea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componente | | Fstán exentos del montale los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir c | | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. | | Mecanismos del ítem 8517,90,91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517,21,10 |
| impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del item 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de t | | ly 8517.21.20; v 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; | | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.39 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las palcas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecán | 1 | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por ferceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento del na pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las palacas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas. | | producción de los mismos atienda lo establecido en los item "A" y "B". No |
| alimentación. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusion en un |
| Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | |
| componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecànicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecànicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subtiem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | alimentacion. |
| y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subitem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. lintegración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | 8473.50.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo. A. Montaje y soldadura de todos los |
| Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del item 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | componentes en las placas de circulto impreso, los montaje de las places electricas |
| en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. lintegración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | len la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | del item 8473 30 22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | 1 | Mecanismos del ítem 8517,90,91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517,21,10 |
| impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | v 8517.21.20; v 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. 8473.50.50 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | de subconiuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| alimentación. PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | ÷ | |
| A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | alimentación. |
| semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | 8473.50.50 | PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL |
| (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | A 50 CM2 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla |
| Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | |
| impreso. 8473.50.90 Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | (ensayo) electrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. |
| Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | |
| componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | 0.470.50.00 | Cumplis con el siguiente procese productivo: A Montaio y coldadura de todos los |
| y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | 8473.50.90 | Companyates on les places de circuito impreso: R. Montaie de las partes eléctricas |
| Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas | | lu macánicas totalmente desagrandas, a nivel hásico de componentes y C |
| en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. | | Integración de las placas de circuito impreso y de las pades eléctricas y mecánicas |
| * ICLIE CHICOLOGIC DE DIGGERE MINER DE RÉSOLES SONTES ASSETTS DE MINERALISTES. | | len la formación del producto final de acuerdo con los item "A" v "B" anteriores |
| Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos | | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |

by if

Sley

Agustín Colombo Sierra Director

| | Director | |
|-------------|--|-----------------------|
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60 | .2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 851 | 7.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.3 | |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utiliz | |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que l | а |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No | |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en la | |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente | es de |
| 0.474.40.00 | alimentación. | |
| 8474.10.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8474.20.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8474.20.90 | 60% de valor agregado regional | - |
| 8474.31.00 | 60% de valor agregado regional | <u> </u> |
| 8474.32.00 | 60% de valor agregado regional | 5 |
| 8474.39.00 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional | - 511- |
| 8474.80.10 | | <u>-9#</u> |
| 8474.80.90 | 100 % de valor agregado regionar | ನೆ//— |
| 8474.90.00 | 60% de valor agregado regional | S// |
| 8475.10.00 | 60% de valor agregado regional | <u> </u> |
| 8475.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8475.29.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8475.29.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8475.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8476.21.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8476.29.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8476.81.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8476.89.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8476.89.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8476.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.10.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.10.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.10.21 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.10.29 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.10.91 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.10.99 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.20.10 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8477.20.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.30.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.30.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.40.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.40.90 | 60% de valor agregado regional | · |
| 8477.51.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.59.11 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.59.19 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.59.90 | 60% de valor agregado regional | ·· ······· |
| 8477.80.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.80.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8477.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8478.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8478.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8478.90.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8479.10.10 | 60% de valor agregado regional | |
| 8479.10.90 | 60% de valor agregado regional | |
| 8479.20.00 | 60% de valor agregado regional | |
| 8479.30.00 | 60% de valor agregado regional | Δ |
| · | | 1 1 |

los d

Lu

Agustín Colombo Sierra

| 8479.40.00 | |
|--|---------------------------------------|
| 8479.60.00 | |
| 8479.81.10 60% de valor agregado regional 8479.81.90 60% de valor agregado regional 8479.82.10 60% de valor agregado regional 8479.82.10 60% de valor agregado regional 8479.82.90 60% de valor agregado regional 8479.89.11 60% de valor agregado regional 8479.89.12 60% de valor agregado regional 8479.89.12 60% de valor agregado regional 8479.89.22 60% de valor agregado regional 8479.89.91 60% de valor agregado regional | |
| 8479.81.90 | |
| 8479.82.10 | |
| 8479.82.90 | |
| B479.82.90 | |
| 8479.89.12 | |
| 8479.89.12 60% de valor agregado regional 60% de valor agregad | 13 |
| 8479.89.21 60% de valor agregado regional 8479.89.22 60% de valor agregado regional 8479.89.40 60% de valor agregado regional 8479.89.91 60% de valor agregado regional 8479.89.91 60% de valor agregado regional 8479.89.92 60% de valor agregado regional 8479.89.99 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional 60% d | 1.0 |
| 8479.89.22 60% de valor agregado regional 8479.89.40 60% de valor agregado regional 8479.89.91 60% de valor agregado regional 8479.89.92 60% de valor agregado regional 8479.90.90 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.00 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.70.00 60% de valor agregado regional 8481.70.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.90 60% de valor agregado regional 8481.30.90 60% de valor agregado regional 8481.80.91 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | [4 |
| 8479.89.40 60% de valor agregado regional 8479.89.91 60% de valor agregado regional 8479.89.92 60% de valor agregado regional 8479.89.99 60% de valor agregado regional 8479.90.90 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.00.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional | 7 |
| 8479.89.91 60% de valor agregado regional 8479.89.92 60% de valor agregado regional 8479.89.99 60% de valor agregado regional 8479.90.90 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8479.89.92 60% de valor agregado regional 8479.89.99 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8479.89.99 60% de valor agregado regional 8479.90.90 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8479.90.90 60% de valor agregado regional 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | - |
| 8480.10.00 60% de valor agregado regional 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.20.00 60% de valor agregado regional 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.30.00 60% de valor agregado regional 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.79.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | · |
| 8480.41.00 60% de valor agregado regional 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.79.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.49.10 60% de valor agregado regional 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8480.49.90 60% de valor agregado regional 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.79.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.50.00 60% de valor agregado regional 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.60.00 60% de valor agregado regional 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.79.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.71.00 60% de valor agregado regional 8480.79.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8480.79.00 60% de valor agregado regional 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.10.00 60% de valor agregado regional 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.20.90 60% de valor agregado regional 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.30.00 60% de valor agregado regional 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.40.00 60% de valor agregado regional 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.21 60% de valor agregado regional 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.29 60% de valor agregado regional 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.39 60% de valor agregado regional 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.92 60% de valor agregado regional 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.93 60% de valor agregado regional 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.94 60% de valor agregado regional | |
| | |
| 8481.80.95 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.96 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.97 60% de valor agregado regional | |
| 8481.80.99 60% de valor agregado regional | |
| 8481.90.90 60% de valor agregado regional | |
| 8483.10.50 60% de valor agregado regional | |
| 8483.40.10 60% de valor agregado regional | - |
| 8483.40.90 60% de valor agregado regional | |
| 8483.60.11 60% de valor agregado regional | |
| 8483.60.19 60% de valor agregado regional | |
| 8483.60.90 60% de valor agregado regional | |
| 8483.90.00 60% de valor agregado regional | |
| 8484.20.00 60% de valor agregado regional | |
| 8486.20.00 60% de valor agregado regional | |
| 60% de valor agregado regional | |
| 60% de valor agregado regional | ——— |
| 60% de valor agregado regional | |
| 60% de valor agregado regional | |

Agustín Colombo Sierra

| | Director |
|-------------|--|
| 8501.34.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.34.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.34.20 | |
| 8501.40.21 | 600/ do valor agreede regional |
| 8501.40.29 | 60% de valor agregado regional // S S S S S S |
| 8501.51.10 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional |
| 8501.51.20 | 60% de valor agregado regional 60% de valor agregado regional 5 SECRETARIA EN SECRETAR |
| 8501.51.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.52.10 | Solve to the distribution of the solve to th |
| | 60% de valor agregado regional |
| 8501.52.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.52.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.53.10 | 60% de valor agregado regional |
| 0001.00.20 | 100% de valor agregado regional |
| 8501.53.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.61.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.62.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.63.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8501.64.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.11.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.11.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.12.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.12.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.13.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.13.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.13.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.20.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.20.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.20.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.31.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.39.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.40.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8502.40.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8503.00.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.21.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.22.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.23.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.33.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.34.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.40.30. | 60% de valor agregado regional |
| 8504.40.50 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.40.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.90.30 | 60% de valor agregado regional |
| 8504.90.40 | 60% de valor agregado regional |
| 8505.20.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8505.20.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8505.90.80 | 60% de valor agregado regional |
| 8505.90.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8508.60.00 | 60% de valor agregado regional |
| | |
| 8510.20.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8510.90.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8511.80.30 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctrica y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánica. |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| L | Jen la formación del producto lina de acuerdo con los tiem A y b antenores. |

les H.

Le

Agustín Colombo Sierra Director

| | Director |
|------------|---|
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los item 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8514.10.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8514,10.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.20.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.20.19 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.20.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.30.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.30.19 | |
| 8514.30.21 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.30.29 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.30.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8514.40.00 | |
| 8514.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.11.00 | 60% de valor agregado regional |
| | 60% de valor agregado regional |
| 8515.19.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.21.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.29.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.31.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.31.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.39.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.80.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.80.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8515.90.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8517.12.11 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.12 | |
| | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje y |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.13 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaie |
| • | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| | |



Agustín Colombo Sierra Director

| SOSA. | Director |
|------------|--|
| 8517.12.21 | Cumplimiento del siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.22 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.23 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.29 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.31 | Cumplimento del siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.33 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto finat. |
| 8517.12.39 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.41 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.49 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.12.90 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |



Agustín Colombo Sierra Director) \ \ **U**

| | S/// Director |
|------------|---|
| 1300 | Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director |
| 024 · 40 | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.18.20 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| İ | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.61.11 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| 0517.01.11 | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| · | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| } | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 0547.64.40 | |
| 8517.61.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| 1 | |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| 8517.61.20 | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| 8517.61.20 | cambio de partida y que cumpia con el siguiente proceso productivo. A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| ļ | |
| ļ. | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | |
| 8517.61.43 | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.61.43 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| 1 | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| 8517.61.49 | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 0517.01.49 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| 1 | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| 1 | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.61.91 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 16.10.1160 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
|] | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.61.92 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| Ì | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.61.99 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| | products friedminas on a formation del products final. |

la of

Slen



Agustín Colombo Sierra Director

| 302A . | Director |
|------------|--|
| 8517.62.11 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.13 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.14 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.21 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.22 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.23 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.24 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.29 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.31 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaja |

les Ef

Sh



Agustín Colombo Sierra Director

| <u> </u> | Director Director |
|-----------------|--|
| GOSA . NO. | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| 234.40 | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.32 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.33 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| 1 | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| 1 | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| Ī | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| <u>L</u> | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.41 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
|]. | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| İ | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| <u> </u> | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.48 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| İ | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| 1 | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.51 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| · · · · · · · · | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| [| soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.53 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; 8 - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.55 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.61 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| · | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.62 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje y |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes: v.D Interración de las placas do circuita impresa y de las recomponentes. |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| <u>-</u> | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |



Agustín Colombo Sierra Director

| 20C | Director Director |
|------------|---|
| 8517.62.64 | REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A-Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por productos; B – Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C – Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D – Integración de las placas d circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.65 | REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A-Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por productos; B – Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C – Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D – Integración de las placas d circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.71 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.72 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.79 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.91 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.93 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.62.94 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |

ly by

Sh

SECRETARÍA DEL MERCOSUR SECRETARÍA Z RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10 GENERAL DE FE DE ERRATAS – ORIGINAL-15/IV/2010

Agustín Colombo Sierra Director

| 1.450 | Agustin Colombo Sierra Director |
|---------------|---|
| 8517.62.95 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.70.10 | Circuitos impresos montados con componentes eléctricos o electrónicos. |
| | Requisito: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los |
| | componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30 |
| 8517.62.96 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| 1 | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.70.92 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaie |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| İ | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.70.99 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| 8518.10.10 | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 03 18. 10. 10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| İ | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8518.29.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje y |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8519.81.20 | 60% de valor agregado regional |
| 8521.10.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8521.10.90 | 60% de valor agregado regional |
| 8521.90.10 | 60% de valor agregado regional |
| 8523.52.00 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS |
| | OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de |
| | la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla |
| | montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación) |
| | E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones |
| | (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico. |
| | químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos |
| | proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas |
| | "A" y "B" anteriores. |
| 8523.59.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto. B Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso: C - Montaie |
| | de las partes electricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |

St.



Agustín Colombo Sierra
Director

| JOSA . | Director |
|------------|---|
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8525.50.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8525.50.29 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8525.60.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| • | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| 8525.60.90 | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje |
| 0323.00.30 | como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y |
| | soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje |
| | de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de |
| | componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes |
| | eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8525.80.11 | 60% de valor agregado regional |
| 8525.80.12 | 60% de valor agregado regional |
| 8525.80.21 | 60% de valor agregado regional |
| 8526.10.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8526.91.00 | 60% de valor agregado regional |
| 8528.41.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los |
| | componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los item 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| , | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |
| | desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un |
| | mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de |
| | alimentación. |
| 8528.41.20 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas |
| | y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. |
| | Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas |
| | en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. |
| | Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos |
| | del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) |
| | Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 |
| | y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para |
| | impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización |
| | de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la |
| | producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No |

ly

Bf.

She